

**中信建投证券股份有限公司**

**关于**

**厦门恒坤新材料科技股份有限公司**

**首次公开发行股票并在科创板上市**

**之**

**上市保荐书**

**保荐人**



**二〇二四年十二月**

## 保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人吴建航、刘劭谦已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

## 目 录

释 义 .....	3
一、发行人基本情况 .....	5
二、发行人本次发行情况 .....	11
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式 .....	13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 .....	16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 .....	16
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 .....	17
七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程 .....	18
八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明 .....	22
九、持续督导期间的工作安排 .....	26
十、保荐人关于本项目的推荐结论 .....	27

## 释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人/中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
恒坤新材、公司、发行人	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司
恒坤有限、有限公司	指	厦门恒坤精密工业有限公司，系发行人前身
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
股东（大）会	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司股东（大）会
董事会	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会
监事会	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司监事会
《公司章程》	指	《厦门恒坤新材料科技股份有限公司章程》
容诚会计师/申报会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
沙利文	指	弗若斯特沙利文，Frost&Sullivan
本次发行	指	厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
报告期、最近三年及一期	指	2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月
报告期各期末	指	2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 6 月 30 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《首次公开发行股票注册管理办法》
半导体	指	半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料，半导体产品主要分为集成电路、分立器件、光电子器件及传感器四类。
集成电路、芯片	指	Integrated Circuit 的简称，指集成电路，通常也叫芯片（Chip），是一种微型电子器件或部件。采用半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块半导体晶片如硅片或介质基片上，然后焊接封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的电子器件。

晶圆	指	晶圆指制造集成电路芯片的衬底（也叫基片）。由于其形状为圆形，所以称为晶圆。在晶圆上可加工制作成各种电路元件结构，而成为有特定电性功能的集成电路产品。按其直径主要分为4英寸、5英寸、6英寸、8英寸、12英寸等规格。
光刻材料	指	光刻工艺中用到的各类型高纯化学材料，包括SOC（碳膜涂层）、ARC（抗反射涂层）、光刻胶、TopCoating、稀释剂、冲洗液、显影液等。
前驱体材料	指	携有目标元素，呈气态或易挥发液态，具备化学热稳定性，同时具备相应的反应活性或物理性能的一类物质；是集成电路制造中薄膜沉积工艺中使用到的一种重要介质，用于形成符合半导体制造要求的各类薄膜层的核心原材料。
碳膜涂层/SOC	指	Spin on Carbon，简称SOC，高碳含量的交联芳香结构聚合物，一般由聚酰胺酸树脂、交联剂和溶剂等混配而成，系一种有机涂层。
抗反射涂层/ARC	指	Anti-Reflection Coating，简称ARC，指涂布在光刻胶底部或顶部等的涂层，由高分子树脂、染料、热致产酸剂、溶剂等组成，系各类抗反射涂层总称，可包括SiARC、BARC、TARC等。
底部抗反射涂层/BARC	指	Bottom Anti-Reflection Coating，简称BARC，涂布在光刻胶底部的抗反射涂层。
含硅抗反射涂层/SiARC	指	Silicon containing Anti-Reflection Coating，简称SiARC，三层光刻工艺涉及光刻材料之一。
顶部抗反射涂层/TARC	指	Top Anti-Reflection Coating，简称TARC，涂布在光刻胶顶部的抗反射涂层。
i-Line 光刻胶	指	应用紫外曝光光源波长为365nm的光刻胶，可应用于集成电路、分立器件等领域
KrF 光刻胶	指	应用氟化氪曝光光源波长为248nm的光刻胶，又称氟化氪光刻胶，主要应用于集成电路领域
元、万元	指	人民币元、万元

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

## 一、发行人基本情况

### （一）发行人概况

公司名称	厦门恒坤新材料科技股份有限公司
注册地址	厦门市海沧区东孚镇山边路 389 号
成立时间	2004 年 12 月 10 日
注册资本	38,192.166 万元人民币
法定代表人	易荣坤
董事会秘书	陈颖峥
联系电话	0592-6208266
互联网地址	www.hengkun.com
主营业务	公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一,主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。报告期内,公司自产产品主要包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料,主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的的光刻、薄膜沉积等工艺环节。此外,在境内集成电路产业替代需求增加的背景下,为快速获取客户资源,并积累产品导入和品控经验,公司以引进境外产品为切入点,引进并销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料。
本次证券发行的类型	首次公开发行股票并在科创板上市

### （二）发行人主营业务、核心技术、研发水平

#### 1、发行人主营业务

公司致力于集成电路领域关键材料的研发与产业化应用,是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一,主要从事光刻材料和前驱体材料等产品的研发、生产和销售。报告期内,公司自产产品主要包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料以及 TEOS 等前驱体材料,主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的的光刻、薄膜沉积等工艺环节。此外,在境内集成电路产业替代需求增加的背景下,为快速获取客户资源,并积累产品导入和品控经验,公司以引进境外产品为切入点,引进并销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿

电子化学品等集成电路关键材料，创新性地走出了一条“引进、消化、吸收、再创新”的发展路径。报告期内，公司客户涵盖了国内领先的晶圆厂，实现境外同类产品替代，打破 12 英寸集成电路关键材料国外垄断。

## 2、发行人核心技术

公司专注于集成电路关键材料的研发与产业化应用，核心技术均系围绕关键材料的研发和生产展开，并进一步延伸至对关键材料上游原材料的研发储备。公司主营业务产品中，光刻材料属于配方型精细化学品，前驱体材料属于高纯化学试剂，在产品研发过程中需要对客户工艺制程与应用需求充分理解，并根据不同客户情况对产品进行改良调整，同时在产品生产过程中需要对产品品质与量产能力全面管控，确保产品品质与生产规模持续满足客户使用需求。

近年来，境内集成电路产业保持蓬勃发展，随着国家战略与行业政策多方位扶持，集成电路产业国产化进程加速，境内晶圆厂在先进制程的研发创新能力、生产制造能力以及市场开拓能力均不断提升。上游关键材料与设备企业作为影响集成电路工艺制程先进性的核心要素，核心技术不仅需具备自主研发和持续创新能力，同时还需具备规模生产和品控管理能力。公司承担并完成国家 02 科技重大专项子课题与国家发改委专项研究任务系具备自主研发和持续创新能力的良好体现，公司累计自产销售超过 28,000 加仑光刻材料系公司规模生产和品控管理的有效佐证。截至报告期末，公司自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款，公司与境内主要 12 英寸集成电路晶圆厂已形成稳定合作机制，提供国产化关键材料技术支撑，为境内集成电路产业发展作出重要贡献。

总体而言，公司作为半导体制造关键材料企业，在配方研发、生产能力、品质管控以及产品应用等方面形成核心技术积累，帮助公司在半导体行业树立行业壁垒，持续稳固核心竞争能力。

截至报告期末，公司拥有关键核心技术情况、技术来源、技术所处阶段等具体情况如下表所示：

序号	核心技术名称	核心技术描述	核心技术所处阶段	核心技术来源
1	光刻材料配方开发技术	技术用于光刻材料配方开发与改良，在产品研发阶段与验证阶段均发挥核心作用。光刻材料属于配方型精细化学品，定制化程度高，细微比例的配比变化、含量调整或组合改良都会对光刻材料的功能与性能产生重大影响。配方开发技术系公司研发光刻材料的基础核心技术。	成熟应用	自主研发
2	光刻图形改善与应用优化技术	技术用于光刻材料在客户验证过程中的分析与优化。技术基础系基于对集成电路光刻工艺的专业理解与经验积累，形成对光刻工艺过程中图形和成像的分析能力。该技术与光刻材料配方开发技术相结合后共同实现光刻材料的持续研发和产品导入。同时，在引进模式下，该技术为公司前期顺利导入中国境外关键材料厂商的光刻材料提供技术支撑。	成熟应用	自主研发
3	碳膜涂层（SOC）生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 SOC 规模生产与品质管控的技术。	部分成熟应用	自主研发
4	抗反射涂层（ARC）生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 BARC、TARC 以及 SiARC 等抗反射涂层规模生产与品质管控的技术。	部分成熟应用	自主研发
5	i-Line 光刻胶生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 i-Line 光刻胶及相关感光类材料规模生产与品质管控的技术。	部分成熟应用	自主研发
6	KrF 光刻胶生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 KrF 光刻胶规模生产与品质管控的技术。	部分成熟应用	自主研发
7	ArF 光刻胶生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用 ArF 光刻胶和 ArF 浸没式光刻胶的技术。	研发中	自主研发
8	光刻工艺化学试剂生产管理技术	用于 12 英寸集成电路晶圆制造用旋涂介电层、Top Coating 等化学试剂规模生产与品质管控的技术。	研发中	自主研发/技术转让
9	树脂制造工艺技术	树脂系光刻材料核心成份，直接影响光刻材料的光学性能、分辨率、蚀刻性能等重要参数。该技术对应自产各类光刻材料的树脂原材料，涵盖树脂合成方法、金属离子去除技术以及添加剂适配等细分技术。通过掌握树脂制造相关技术，公司可实现对光刻材料核心原材料的自主可控。	部分成熟应用	自主研发/技术转让
10	硅基前驱体材料生产管理技术	用于 TEOS 等硅基前驱体材料规模生产与品质管控的技术。	部分成熟应用	技术授权/自主研发
11	金属基前驱体材料生产管理技术	用于四氯化钨等金属基前驱体材料规模生产与品质管控的技术。	研发中	自主研发

过去半个多世纪，全球范围集成电路产业发展一直遵循摩尔定律。在摩尔定律技术基础上，只要光刻工艺精度不断提高，元器件密度会相应提高，工艺制程



或技术节点也将持续缩小。以逻辑芯片为例，从 1995 年 350nm 面世以来，集成电路产业每过 18 个月至 24 个月即会研发形成新的技术节点，到 2023 年，全球范围内已有晶圆厂实现逻辑芯片 3nm 技术节点量产。在全球集成电路产业发展过程中，对于关键材料包括光刻材料、前驱体材料以及电子特气等一直保持需求增长态势。境内集成电路产业起步较晚，公司所掌握核心技术及对应产品处于境内集成电路关键材料领先地位，已覆盖 128 层及以上 3D NAND、18nm 及以下 DRAM 存储芯片以及 7-90nm 技术节点逻辑芯片，系当前境内集成电路产业主要布局范围。公司将通过自主研发助力境内集成电路产业不断升级迭代，追赶世界先进水平，实现高水平科技自立自强。

### 3、发行人研发水平

报告期内，公司研发费用分别为 2,999.31 万元、4,274.36 万元、5,366.27 万元和 3,515.51 万元，合计研发投入达 16,155.45 万元。公司围绕集成电路光刻材料和前驱体材料进行产品和技术的创新研发，报告期内共计开展了 12 个大类，超过 45 个小类的产品和技术研发项目。未来，公司将持续加大对集成电路关键材料的研发力度，进一步提升公司整体研发能力。

2020 年开始，公司先后承接国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务，并均已完成验收。2023 年，公司新增承接多项国家多部委重要攻关任务。公司子公司福建泓光于 2020 年评为福建省集成电路光刻胶关键材料工程研究中心，并于 2022 年度被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，其“集成电路用旋涂碳光刻胶材料研发及产业化”项目先后获得工信部指导或主办的“创响福建”一等奖和“创客中国”三等奖。同时，公司在光刻材料与前驱体材料均有专利布局，截至报告期末，公司拥有专利 80 项，其中发明专利 30 项。

综上，公司已建立较为完善的技术创新体系，长期坚持自主创新并取得多项技术成果，具备较强的科技创新能力。

### （三）发行人主要经营和财务数据及指标

项目	2024.6.30/ 2024 年 1-6 月	2023.12.31/ 2023 年度	2022.12.31/ 2022 年度	2021.12.31/ 2021 年度
资产总额（万元）	249,188.91	209,108.60	163,289.60	81,541.98

项目	2024.6.30/ 2024年1-6月	2023.12.31/ 2023年度	2022.12.31/ 2022年度	2021.12.31/ 2021年度
归属于母公司所有者权益（万元）	143,658.61	138,162.07	127,356.58	50,953.78
资产负债率（%）	42.35	33.92	22.19	37.75
营业收入（万元）	23,786.49	36,770.78	32,176.52	14,116.91
净利润（万元）	4,409.92	8,976.26	9,972.83	2,656.42
归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,410.44	8,984.93	10,090.30	3,012.86
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,106.56	8,152.78	9,103.53	967.56
基本每股收益（元）	0.12	0.24	0.30	0.11
稀释每股收益（元）	0.11	0.23	0.30	0.11
加权平均净资产收益率（%）	3.14	6.78	14.72	7.67
经营活动产生的现金流量净额（万元）	15,640.15	8,796.42	14,933.43	2,970.39
研发投入（万元）	3,515.51	5,366.27	4,274.36	2,999.31
研发投入占营业收入的比例（%）	14.78	14.59	13.28	21.25

注：上述财务指标的计算公式如下：

1、资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

2、基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数

3、稀释每股收益=P1/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

4、加权平均净资产收益率=P0/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产

从报告期期初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产不予加权计算（权重为零）。

5、研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

#### **（四）发行人存在的主要风险**

##### **1、新产品未能实现产业化的风险**

公司主要从事 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料的研发、生产和销售，旨在解决集成电路制造领域关键材料自主可控。为持续满足客户的国产化需求，并保持公司的核心竞争力和市场地位，公司需不断进行新产品的开发。但是，新产品开发能否取得预期的研发成果，并通过客户验证以顺利实现量产存在一定不确定性。如新产品开发失败或因客户需求发生变化，导致新产品无法实现产业化，则将对公司未来的业绩增长造成不利影响。

##### **2、与引进产品供应商合作终止或交易条件发生重大不利变化的风险**

报告期内，公司引进产品销售毛利分别为 9,419.51 万元、18,940.90 万元、16,791.56 万元和 8,863.76 万元，占公司主营业务毛利的比例分别为 99.30%、82.05%、74.42%和 68.48%，占比逐年降低，但仍是公司重要的利润来源之一。报告期内，公司与引进产品供应商合作稳定。在后续合作过程中，如公司无法与引进产品供应商就采购价格或其他交易条件达成一致意见，则可能影响公司与引进产品供应商之间的合作关系。如果公司与主要引进产品供应商合作终止或交易条件发生重大不利变化，则将导致公司引进产品销售收入和毛利下降，并对公司的经营产生不利影响。

##### **3、客户集中度较高的风险**

报告期内，公司前五大客户（同一控制下合并计算）的收入占主营业务收入的比例分别为 99.40%、99.22%、97.92%和 97.35%，客户集中度较高。公司产品目前主要应用于集成电路领域，下游客户主要系晶圆厂，行业集中度较高致使客户集中度较高。未来，若公司现有主要客户发展战略发生重大变化，或由于经营不善、产业政策调整、行业竞争加剧以及突发事件等原因导致业绩下滑，进而减少对公司产品的采购金额，而公司未能及时开拓新客户或取得其他应用领域的新

订单，则将对公司盈利能力产生不利影响。

#### 4、贸易摩擦影响原材料与设备供应的风险

公司产品所需的原材料主要为树脂、添加剂、溶剂以及其他辅料耗材等，所需的设备主要为光刻机、缺陷扫描仪等检测设备，光刻材料和前驱体材料生产设备等。目前该等原材料与设备或设备核心组件主要仍需通过进口，受国际贸易形势的影响较大。虽然，公司已通过技术转让和自主研发相结合方式，致力将光刻材料核心原材料树脂实现国产化应用落地，降低原材料供应链的潜在风险，但是，受国际政治经济不确定性增强、国际贸易保护主义抬头等因素影响，将可能导致关键原材料和设备供应紧张甚至断供，进而对公司的技术升级及产品交付能力造成不利影响。

#### 5、自产前驱体材料毛利率为负的风险

报告期内，公司自产前驱体材料毛利率分别为-644.76%、-329.59%、-19.91%和-8.67%，毛利率持续上升但仍为负值，主要是因为产品处于市场推广期，产量较低，单位固定成本较高。未来，如公司自产前驱体材料无法获得持续的规模化订单以降低单位固定成本，则相关产品的毛利率将降低或可能持续为负，相关固定资产亦将面临减值风险，进而对公司的整体盈利能力造成不利影响。

#### 6、募集资金投资项目实施不及预期的风险

公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前中国境内外市场环境、行业发展趋势和技术水平等因素作出的。但上述项目需要一定的建设周期，一旦市场环境、技术、管理、人才等方面出现重大变化，项目在实施过程中可能受到市场环境、产业政策以及项目管理、产品及服务市场销售状况等变化因素的不利影响，将影响项目的实施进度，致使项目的实际效益情况与公司预测存在差异，面临募集资金投资项目实施效果不及预期的风险。

## 二、发行人本次发行情况

### (一) 本次发行的基本情况

股票种类	境内上市人民币普通股（A股）股票
------	------------------

每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 6,739.7940 万股 (行使超额配售选择权之前)	占发行后总股本比例	不低于 10%
其中: 发行新股数量	不超过 6,739.7940 万股 (行使超额配售选择权之前)	占发行后总股本比例	不低于 10%
股东公开发售股份数量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	不超过 44,931.9600 万股 (行使超额配售选择权之前)		
每股发行价格	人民币【】元		
发行市盈率	【】倍 (根据发行价格除以发行后每股收益计算, 发行后每股收益按照【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)		
发行前每股净资产	人民币【】元	发行前每股收益	人民币【】元
发行后每股净资产	人民币【】元	发行后每股收益	人民币【】元
发行市净率	【】倍 (每股发行价格除以发行后每股净资产)		
发行方式	本次发行将采用网下向符合资格的投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式, 或证券监管机构认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的符合资格的科创板市场投资者以及符合证券监管机构规定的其他投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)		
承销方式	余额包销		
募集资金总额	人民币【】万元		
募集资金净额	人民币【】万元		
募集资金投资项目	集成电路前驱体二期项目 SiARC 开发与产业化项目 集成电路用先进材料项目		
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元		
高级管理人员、员工拟参与战略配售情况	若公司决定实施高管及员工战略配售, 则在本次公开发行股票注册后、发行前, 履行内部程序审议该事项的具体方案, 并依法进行披露。		
保荐人相关子公司拟参与战略配售情况	保荐人将安排相关子公司参与本次发行战略配售, 具体按照上交所相关规定执行。保荐人及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案, 并按规定向上交所提交相关文件。		
<b>(二) 本次发行上市的重要日期</b>			
刊登发行公告日期	【】年【】月【】日		
开始询价推介日期	【】年【】月【】日		
刊登定价公告日期	【】年【】月【】日		
申购日期和缴款日期	【】年【】月【】日		

股票上市日期

【】年【】月【】日

### 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

#### （一）本次证券发行上市的保荐代表人

吴建航先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：英可瑞 IPO、读客文化 IPO、云从科技 IPO、硕中科技 IPO、立方控股北交所上市、宝通科技再融资、高德红外再融资、宝通科技发行股份购买资产及配套融资、拓尔思发行股份购买资产及配套融资、国泰集团发行股份购买资产及配套融资、中国移动财务顾问等项目，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘劲谦先生：保荐代表人、注册会计师，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监。曾主持或参与的项目有：浩辰软件科创板 IPO、灿勤科技科创板 IPO、同享科技精选层挂牌、翰博高新精选层挂牌、创远仪器精选层挂牌、同惠电子精选层挂牌、骏创科技北交所上市、华岭股份北交所上市、特瑞斯北交所上市、欧普泰北交所上市、鼎智科技北交所上市、戈碧迦北交所上市、瑞华技术北交所上市、通鼎互联可转债、奥瑞金可转债、歌尔股份可转债、风语筑可转债、仙琚制药非公开发行、安诺其非公开发行、同享科技非公开发行等项目，作为保荐代表人现在尽职推荐的项目有：无。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

#### （二）本次证券发行上市项目协办人

郭炜先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：西部超导 IPO、铂力特 IPO、德龙激光 IPO、锋尚文化 IPO、顾家家居 IPO、立方控股北交所上市、华岭股份北交所上市、创远仪器精选层挂牌、同惠电子精选层挂牌、中威电子再融资、奥瑞金再融资、杭州高新收购、小商品城重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

### （三）本次证券发行上市项目组其他成员

廖小龙先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会执行总经理，曾主持或参与的主要项目有：小康股份 IPO、云从科技 IPO、顾中科技 IPO、立方控股北交所项目、高德红外非公开发行股票项目、小康股份公开发行可转债项目、小康股份发行股份购买资产项目、国泰集团发行股份购买资产及配套融资项目、泛海控股非公开发行股票项目、慈文传媒重组项目、友宝在线新三板挂牌及 IPO 辅导、中广核能源债权融资项目、群兴玩具重大资产重组项目、立方控股新三板挂牌及定增项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

林天先生：保荐代表人，注册会计师，法律职业资格，本科学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有：新光光电、锋尚文化等 IPO 项目、欧普泰、华岭股份、科达自控、翰博高新、创远信科等北交所上市项目；翰博高新转板上市项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

蔡怡希女士：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：欧普泰北交所上市、宏海科技北交所上市、风语筑可转债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

邓智威先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：顾中科技 IPO、立方控股北交所上市、钢研纳克 IPO、路德环境 IPO、同益中 IPO、盈康生命非公开项目、雪榕生物非公开项目、斯莱克可转债项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

刘凯先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：骏创科技北交所上市、特瑞斯北交所上市、宏海科技北交所上市、风语筑可转债、同享科技向特定对象发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张芮钦先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：硕中科技 IPO、立方控股北交所上市、云从科技再融资等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

魏潇天先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

甄逸恒先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理，曾参与的项目有：宏海科技北交所上市等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

曹清扬先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会经理。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

熊峰先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾参与的项目有：特瑞斯北交所上市、宏海科技北交所上市、骏创科技向特定对象发行股票（在审）、同享科技向特定对象发行股票（在审）等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

余昊天先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：浩辰软件科创板 IPO，特瑞斯北交所上市，水发集团收购派思股份控制权，同享科技向特定对象发行股票等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王飞跃先生：保荐代表人，注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁。曾主持或参与的项目有：云涌科技 IPO、美诺华 IPO、西大门 IPO、三联虹普重大资产重组、骏创科技北交所上市、立方控股北交所上市、瑞华技术北交所上市、骏创科技向特定对象发行股票（在审）等



项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

#### **(四) 联系地址、电话和其他通讯方式**

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 10 层
邮编：	100020
联系电话：	010-85156488
传真：	010-65608451

#### **四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明**

（一）截至本上市保荐书签署日，除中信建投证券全资子公司中信建投资本管理有限公司担任执行事务合伙人的浙港春霖、新投春霖分别持有发行人 1.40%、0.58% 的股份外，保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）截至本上市保荐书签署日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）截至本上市保荐书签署日，保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）截至本上市保荐书签署日，保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

#### **五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项**

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

(一)有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

(二)有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(三)有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

(四)有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

(五)保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

(六)保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(七)保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

(八)自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

(九)中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

## **六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》 《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明**

2024年9月23日，发行人召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

2024年10月8日，发行人召开2024年第五次临时股东会，审议通过了《关

于公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

经核查，保荐人认为，发行人首次公开发行股票并在科创板上市方案已经取得发行人董事会、股东会批准，发行人董事会、股东会就本次发行上市有关议案召集的会议及作出的决议，其决策程序及决议内容符合《公司法》《证券法》、中国证监会相关规定以及上交所有关业务规则等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。发行人股东会授权董事会办理有关本次发行上市事宜的授权程序合法、内容明确具体，合法有效。

## **七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程**

### **（一）发行人符合科创板定位情况**

#### **1、发行人符合科创板支持方向**

##### **（1）公司主营业务围绕集成电路关键材料，符合国家战略和新质生产力发展方向**

2020年7月，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，明确为进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等方面制定政策。2020年9月，国家发改委、科技部、工信部、财政部联合发布《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》，意见提出：加快新材料产业强弱项。围绕保障大飞机、微电子制造、深海采矿等重点领域产业链供应链稳定，加快在光刻胶、高纯靶材、高温合金、高性能纤维材料、高强高导耐热材料、耐腐蚀材料、大尺寸硅片、电子封装材料等领域实现突破。2021年12月，国务院发布《关于印发“十四五”数字经济发展规划的通知》，提出：瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给水平，强化关键产品自给保障能力。2024年3月，政府工作报

告提出：加快推动高水平科技自立自强。充分发挥新型举国体制优势，全面提升自主创新能力。积极培育新兴产业和未来产业。加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎。

2024 年，证监会相继出台《关于资本市场服务科技企业高水平发展的十六项措施》和《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，明确“优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的‘硬科技’企业在科创板上市”以及“集中力量支持重大科技攻关。加强与有关部门政策协同，精准识别科技型企业，优先支持突破关键核心技术的科技型企业上市融资、并购重组、债券发行，健全全链条‘绿色通道’机制”。

集成电路关键材料是培育和发展集成电路新质生产力的关键领域，实现关键材料自主可控是解决集成电路核心技术难题的上游基础。公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，已实现量产供货产品包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等光刻材料和 TEOS 等前驱体材料，相关产品主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节，系 12 英寸集成电路晶圆制造核心制程与核心工艺不可或缺的关键材料，全面助力实现国家集成电路国产化战略。因此，公司主营业务符合国家战略方向，系集成电路领域突破关键核心技术的“硬科技”企业。

## **(2) 公司拥有关键核心技术，产品已陆续产业化并实现进口替代**

公司专注于集成电路关键材料的研发与产业化应用，核心技术均系围绕关键材料的研发和生产展开，并进一步延伸至对关键材料上游原材料的研发储备。公司主营业务产品中，光刻材料属于配方型精细化学品，前驱体材料属于高纯化学试剂，在产品研发过程中需要对客户工艺制程与应用需求充分理解，并根据不同客户情况对产品进行改良调整，同时在产品生产过程中需要对产品品质与量产能力全面管控，确保产品品质与生产规模持续满足客户使用需求。

近年来，境内集成电路产业保持蓬勃发展，随着国家战略与行业政策多方位扶持，集成电路产业国产化进程加速，境内晶圆厂在先进制程的研发创新能力、生产制造能力以及市场开拓能力均不断提升。上游关键材料与设备企业作为影响集成电路工艺制程先进性的核心要素，核心技术不仅需具备自主研发和持续创新

能力，同时还需具备规模生产和品控管理能力。公司承担并完成国家 02 科技重大专项子课题与国家发改委专项研究任务系具备自主研发和持续创新能力的良好体现，公司累计自产销售超过 28,000 加仑光刻材料系公司规模生产和品控管理的有效佐证。截至报告期末，公司自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款，公司与境内主要 12 英寸集成电路晶圆厂已形成稳定合作机制，提供国产化关键材料技术支撑，为境内集成电路产业发展作出重要贡献。

### **(3) 公司集中力量支持重大科技攻关，已承接多个国家专项任务**

2020 年开始，公司先后承接国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务，均已结题并通过主管部门验收，对应产品已实现销售，成功助力集成电路国产化战略。2023 年，公司新增承接多项国家多部委重要攻关任务。

### **(4) 公司行业地位突出，市场认可度高**

现阶段，境内光刻材料与前驱体材料仍然系由境外厂商占据主要市场份额，境内关键材料企业虽然已有突破，但是尚未在先进技术节点形成大规模替代的局面。以公司自产光刻材料为例，根据弗若斯特沙利文市场研究，在 12 英寸集成电路领域，i-Line 光刻胶、SOC 国产化率 10%左右，BARC、KrF 光刻胶国产化率 1-2%左右，ArF 光刻胶国产化率不足 1%。在未来一定时期内，境内关键材料企业仍将以国产化应用为主要突破方向。公司是境内少数实现光刻材料与前驱体材料量产供货企业之一，根据弗若斯特沙利文市场研究，2023 年度，公司 SOC 与 BARC 销售规模均已排名国内市场国产厂商第一位。

## **2、发行人符合科创板行业领域的规定**

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体材料两大类，并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。

根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的电子专用材料制造（C3985）。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路产业，具体为“1 新一代信息技术产业—1.3 电子核

心产业—1.3.1 集成电路（集成电路材料）”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“3 新材料产业—3.3 先进石化化工新材料—3.3.6 专用化学品及材料制造（C3985 电子专用材料制造）”。根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，公司产品属于“020106 高储能和关键电子材料制造——3985 电子专用材料制造”。此外，根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，公司产品属于关键战略材料，具体为“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”之“242 超高纯化学试剂”与“243 集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂”。

从相关目录分析，公司兼具“新一代信息技术”和“新材料”的产业属性，从公司产品主要应用领域、主要客户群体、承担重大科研专项等方面分析，公司“新一代信息技术”产业属性更为突出：一方面，公司销售产品主要应用于 12 英寸集成电路制造领域，报告期内主要客户均系境内知名晶圆厂；另一方面，公司先后承接并完成国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务，打破境外厂商对集成电路关键材料垄断。

综上所述，公司所属行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中第四条第（一）款规定的“新一代信息技术领域”。

### 3、发行人符合科创属性相关指标要求

公司同时符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第六条科创属性规定的 4 项指标，符合科创板定位，具体指标情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例 $\geq 5\%$ ，或最近三年累计研发投入金额 $\geq 8000$ 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	公司最近三年累计研发投入金额 12,639.93 万元，超过 8,000 万元。
研发人员占当年员工总数的比例超过 10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2023 年末，公司研发人员占比 15.18%，超过 10%。
应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利 $\geq 7$ 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至报告期末，公司应用于主营业务并能够产业化的发明专利 30 项，超过 7 项。
最近三年营业收入复合增长率 $\geq 25\%$ ，或最近一年营业收入金额 $\geq 3$ 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2023 年实现营业收入 3.68 亿元，超过 3 亿元。

## （二）发行人符合国家产业政策情况

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体材料两大类，并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司属于新一代信息技术产业中的集成电路产业，具体为“1 新一代信息技术产业—1.3 电子核心产业—1.3.1 集成电路（集成电路材料）”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类（2018）》，公司产品属于“3 新材料产业—3.3 先进石化化工新材料—3.3.6 专用化学品及材料制造（C3985 电子专用材料制造）”。根据国家统计局《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》，公司产品属于“020106 高储能和关键电子材料制造——3985 电子专用材料制造”。此外，根据工信部发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，公司产品属于关键战略材料，具体为“关键战略材料”之“三、先进半导体材料和新型显示材料”之“242 超高纯化学试剂”与“243 集成电路用光刻胶及其关键原材料和配套试剂”。因此，保荐人认为，发行人符合国家产业政策。

## 八、保荐人关于发行人是否符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件的说明

### （一）发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

保荐人对发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市是否符合《注册管理办法》规定的发行条件进行了逐项核查，核查结果如下：

#### 1、发行人的设立及持续经营时间

保荐人调阅了发行人工商档案、相关审计报告、改制资料等，经核查，发行人系 2014 年 4 月由恒坤有限按原账面净资产值折股整体变更而来，至今已持续经营 3 年以上。保荐人查阅了发行人的《公司章程》、历次董事会、监事会、股东（大）会会议记录、决议及相关制度文件，确认发行人已依法建立健全了法人治理结构，股东（大）会、董事会、监事会、经理层各司其职，组织机构的设置符合《公司法》和其他法律、法规的规定，确认发行人具备健全且运行良好的组

织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

因此，保荐人认为：发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责，符合《注册管理办法》第十条的规定。

## **2、发行人财务规范情况**

本保荐人查阅了发行人的相关财务管理制度，确认发行人会计基础工作规范；申报会计师出具了标准无保留意见的审计报告，确认发行人财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量。因此，发行人符合《注册管理办法》第十一条第一款的规定。

## **3、发行人内部控制情况**

本保荐人查阅了发行人的内部控制制度，并查阅了申报会计师出具的《内部控制鉴证报告》，发行人的内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，申报会计师出具了无保留结论的《内部控制鉴证报告》，符合《注册管理办法》第十一条第二款的规定。

## **4、发行人资产完整性及业务、人员、财务、机构独立情况**

本保荐人查阅了发行人及其控股股东、实际控制人控制的其他企业工商档案和相关内部管理制度，关联方清单和《公司章程》，关联交易相关合同和财务凭证，并对主要股东进行了访谈，经核查确认发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册管理办法》第十二条第一款规定。

## **5、业务、控制权及管理团队的稳定性**

本保荐人查阅了发行人的《公司章程》、历次董事会、股东（大）会决议和记录、工商登记文件及发行人财务报告，对发行人核心技术人员、高级管理人员进行了访谈，经核查发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，



最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；实际控制人和受实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，符合《注册管理办法》第十二条第二款之规定。

## 6、资产权属情况

本保荐人查阅了行业发展规划及政策文件，商标及专利注册登记部门、各级人民法院等公开披露信息，并对发行人高级管理人员和控股股东、实际控制人进行了访谈，经核查确认发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，符合《注册管理办法》第十二条第三款之规定。

## 7、发行人经营合法合规性

本保荐人查阅了发行人的《营业执照》《公司章程》及所属行业相关法律法规，生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件，访谈了发行人部分高级管理人员，实地察看了发行人生产经营场所，取得了发行人无违法违规的相关证明，经核查确认发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策，符合《注册管理办法》第十三条第一款的规定。

## 8、发行人、控股股东及实际控制人的守法情况

本保荐人通过网络检索、查阅工商档案，取得发行人关于重大违法违规情况的说明、相关处罚文件及相关部门出具的证明文件，取得公安机关出具的发行人控股股东、实际控制人的无犯罪记录证明，对发行人高级管理人员进行访谈的方式进行了核查，经核查，保荐人确认，最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《注册管理办法》第十三条第二款的规定。

## 9、董事、监事和高级管理人员的守法情况

本保荐人查询了证监会、证券交易所及中国裁判文书网等网站，取得了相关人员的声明文件，经核查确认发行人董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规和规章规定的任职资格，不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形，符合《注册管理办法》第十三条第三款之规定。

### **(二)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(二)发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元”规定**

本次发行后发行人的股本总额不少于人民币 3,000.00 万元，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）2.1.1 条第（二）项的规定。

### **(三)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(三)公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定**

经核查，本次发行后，公司股本总额超过人民币 4 亿元，本次拟发行股份占发行后总股本的比例达到 10% 以上。

### **(四)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(四)市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定**

公司 2022 年度及 2023 年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 9,103.53 万元和 8,152.78 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于 5,000.00 万元。结合公司同行业可比公司在境内市场近期估值情况，基于对公司市值的预先评估，预计公司本次发行后总市值不低于人民币 10 亿元，满足市值及财务指标标准。

### **(五)发行人符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.1 条之“(五)上海证券交易所规定的其他上市条件”规定**

经核查，发行人符合上海证券交易所规定的其他上市条件。

## 九、持续督导期间的工作安排

事项	工作计划
(一) 持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间及以后 3 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
督导发行人履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务, 审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	<p>1、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度, 审阅信息披露文件及其他相关文件, 确信上市公司向交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;</p> <p>2、对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、交易所提交的其他文件进行事前审阅(或在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内, 完成对有关文件的审阅工作), 对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充, 上市公司不予更正或补充的, 及时向交易所报告;</p> <p>3、关注公共传媒关于上市公司的报道, 及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的, 及时督促上市公司如实披露或予以澄清; 上市公司不予披露或澄清的, 及时向交易所报告。</p>
督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	<p>1、督导发行人遵守《公司章程》及有关决策制度规定;</p> <p>2、参加董事会和股东会重大事项的决策过程;</p> <p>3、建立重大财务活动的通报制度;</p> <p>4、若有大股东、其他关联方违规占用发行人资源的行为, 及时向中国证监会、交易所报告, 并发表声明。</p>
督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	<p>1、督导发行人依据《公司章程》进一步完善法人治理结构, 制订完善的分权管理和授权经营制度;</p> <p>2、督导发行人建立对高管人员的监管机制, 完善高管人员的薪酬体系;</p> <p>3、对高管人员的故意违法违规的行为, 及时报告中国证监会、证券交易所, 并发表声明。</p>
督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度, 并对关联交易发表意见	<p>1、督导发行人进一步完善关联交易的决策制度, 根据实际情况对关联交易决策权力和程序做出相应的规定;</p> <p>2、督导发行人遵守《公司章程》中有关关联股东和关联董事回避的规定;</p> <p>3、督导发行人严格履行信息披露制度, 及时公告关联交易事项;</p> <p>4、督导发行人采取减少关联交易的措施。</p>
持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	<p>1、督导发行人严格按照招股说明书中承诺的投资计划使用募集资金;</p> <p>2、要求发行人定期通报募集资金使用情况;</p> <p>3、因不可抗力致使募集资金运用出现异常或未能履行承诺的, 督导发行人及时进行公告;</p> <p>4、对确因市场等客观条件发生变化而需改变募集资金用途的, 督导发行人严格按照法定程序进行变更, 关注发行人变更的比例, 并督导发行人及时公告。</p>
持续关注发行人为他人提供担保等事项, 并发表意见	<p>1、督导发行人严格按照《公司章程》的规定履行对外担保的决策程序;</p> <p>2、督导发行人严格履行信息披露制度, 及时公告对外担保事项;</p> <p>3、对发行人违规提供对外担保的行为, 及时向中国证监会、证券交易所报告, 并发表声明。</p>
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导	<p>1、提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息;</p> <p>2、根据有关规定, 对发行人违法违规行为事项发表公开声明。</p>

事项	工作计划
职责的其他主要约定	
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、督促发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定； 2、对中介机构出具的专业意见存在疑义的，督促中介机构做出解释或出具依据。
(四) 其他安排	在保荐期间与发行人及时有效沟通，督导发行人更好地遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关法律法规的规定。

## 十、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：恒坤新材首次公开发行上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为恒坤新材首次公开发行上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于厦门恒坤新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 郭炜

郭炜

保荐代表人签名: 吴建航      刘劭谦

吴建航

刘劭谦

内核负责人签名: 张耀坤

张耀坤

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名: 王常青

王常青

